公司代码:688403　　公司简称:汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分派预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利82,440,627.70元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.06%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司2023年度利润分派预案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十九次会议审议,尚需提交公司2023年年度股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	奚鹏	王赞
办公地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

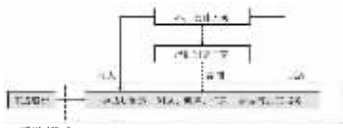
公司目前主要所封装测试的产品应用于显示驱动领域,以提供全制程封装测试为目标,涉及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造(Gold Bumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF),具体情况如下:

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,在OSAT模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司根据客户需求,通过工艺设计,利用封装测试设备,自行购买封装测试原辅料,对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务收取加工服务费的方式以获取收入和利润。具体图示如下:



2、采购模式

公司的采购模式为按需采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单并签约。

对于主要采购材料,公司一般会与供应商约定年度协议价格,未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款,由物料采购部根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后,到期支付款项。

采购材料到货后由品质保障部进行验收,品质保障部核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检,检验合格后在系统中制作验收单,经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制,以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购,评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等,并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面,对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制,以销定产”受托加工生产模式,即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料,公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料,接着根据客户需求完成相应工艺制程,而后将成品交付予客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务,拥有专业的工程技术和生产管理团队,并配备了专业的高精度自动化生产设备,可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业,公司需要对客户的技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务,并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式,公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点,整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下,与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

金凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定,含金原料是金凸块制造环节的主要材料成本,定价结合黄金的市场价格及不同规格芯片所需耗用的黄金用量确定。

晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求,综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下,与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒,并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势,进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段,具体情况如下:

(1)项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心会定期调研行业发展趋势,结合公司发展战略及现有技术基础,选择相应的新工艺、新产品的研发立项;二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息,形成对市场需求的综合判断,针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

(2)项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后,将先进行初步论证,如初步论证可行,则会同公司管理层共同讨论立项建议,根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判,确定具体研发内容,进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署,形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

(3)工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求,开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组,积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后,将召开评审会议,对项目取得相应的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果,对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善,并及时反馈给研发中心相关负责人。

(4)样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制,专项课题小组辅以监督和技术指导,试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的,则样品还需经过客户验证。

(5)研发结项

在验证合格后,研发中心将召开项目评审会,对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告,项目研发工作结束。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域,封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片。根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。

(2)行业发展阶段及基本特点

半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类,广泛应用于消费类、高性能计算、通信类、汽车和工业等重要领域。其中,集成电路是20世纪50年代发展起来的一种半导体微型器件,是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺,按照一定的电路互联,把晶体管、电阻、电容、电感等电子元器件及连接导线,全部集成在微型硅片上,构成具有一定功能的电路,然后封装成电子微型器件,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。集成电路是半导体产业的核心,因为其技术的复杂性,产业结构具备高度专业化的特征,可细分为芯片设计、晶圆制造、封装测试三个子行业,封装测试行业位于产业链的中下游,该业务实质上包括了封装和测试两个环节,但由于测试环节一般也主要由封装厂商完成,因而一般统称为封装测试业。

封装是将芯片在基板上布局、固定及连接,并用绝缘介质封装形成电子产品的过程,目的是保护芯片免受损伤,保证芯片的散热性能,以及实现电信号的传输。测试则包括进入封装前的晶圆测试以及封装完成后的成品测试,晶圆测试主要检验的是每个晶粒的电性,成品测试主要检验的是产品电性和功能。

封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业,在世界上拥有较强竞争力,全球的封装测试产业正在向中国大陆转移。国内的集成电路产业结构中芯片设计、晶圆制造、封装测试各环节总体销售规模呈现均衡的态势,有利于形成集成电路行业的内循环,随着上游芯片设计产业的加快发展,也能够推进处于产业链下游的封装测试行业的发展。

封装技术历经较长的发展过程,形成了复杂多样的封装形式,大致可以划分为五个发展阶段:20世纪70年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段,以通孔插装型封装为主;20世纪80年代以后开始进入第二阶段,以表面贴装型封装为主;20世纪90年代以后,以芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、球栅阵列封装(BGA)为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟,进入封装技术发展的第三阶段;20世纪末开始,凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)等技术推动集成电路封装进入第四阶段;进入21世纪之后,倒装封装(FC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、系统级单芯片封装(SoC)、扇出型封装(Fan-out)等形式的集成电路封装层出不穷,封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》,并结合行业内按照封装工艺分类的惯例,封装分为传统封装(第一阶段和第二阶段)及先进封装(第三至第五阶段)。

传统封装与先进封装的主要区别包括键合方式由传统的引线键合发展为球状凸点焊接,封装元件概念演变为封装系统,封装对象由单芯片向多芯片发展,由平面封装向立体封装发展。目前,全球封装行业的主流技术处于以CSP、BGA为主的第三阶段,并向以倒装封装(FC)、凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)、系统级单芯片封装(SoC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

集成电路产业诞生于美国,并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来,但是随着产业的技术进步和市场发展,封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区,也是目前全球最大的集成电路封装测试基地,中国大陆位居其次。2010年以来,全球集成电路产业与显示面板产业向中国大陆转移的趋势增强。2018年中美贸易战后,基于供应链安全的战略考量,在显示驱动芯片领域甚至更广泛的集成电路领域,越来越多的晶圆厂和设计公司顺应向中国大陆产业转移的大趋势,中国大陆的晶圆代工产能快速攀升,并且众多Fabless设计公司也将封装测试订单逐步转移至中国大陆。

(3)主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业,先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征,决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。显示驱动芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求,客户验证和导入的周期较长,目前国内仅有少量企业具备显示驱动芯片封装测试全流程核心工艺技术并批量稳定供应头部客户。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

金凸块制造环节具有溅镀、黄光(光刻)、蚀刻、电镀等多道环节,需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚,对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高的要求,并且显示驱动芯片成本经济性也对金凸块制程当中的黄金用量控制技术提出了很高的要求,因而目前中国大陆具备凸块制造能力的封测企业较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板,单块液晶面板的价值较高,特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户,封测企业将面临较大金额的质量赔付,并且还存在声誉损失甚至客户流失。正是因为客户以及终端对良率的高要求,倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率,保证生产稳定性,行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力,及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一,具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力,致力于先进封装技术的研究与应用,深耕显示驱动芯片封装测试领域多年,在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术,在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺,该部分技术在行业内处于发展的前沿,拥有较高的技术壁垒,公司技术水平在行业中处于领先地位。

凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与出众的服务能力,公司积累了优质的客户资源,包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名芯片设计企业,公司产品服务质量已得到行业客户的高度认可,并曾获得全球领先的显示驱动IC设计公司联咏科技颁发的最佳品质供应商等荣誉。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着智能手机、智能穿戴等电子产品持续向小型化、多功能化方向发展,对芯片在集成化、小尺寸、低功耗等方面的要求也越来越高。在后摩尔定律时代,以FC、2.5D/3D封装、Fan-out、SiP等为代表的先进封测正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向,先进封装在整体封装环节的占比正稳步提升,成为封测市场的主要增长点。特别是近年来人工智能、云计算等下游新兴应用场景的需求飞速发展,正在加速集成电路产业供应链的变革与发展,对封测工艺及产品性能提出了更高的要求,将进一步推动先进封测技术进行迭代并快速增长,先进封测领域有望迎来一轮快速发展机遇。

在下游显示面板领域,随着消费升级和技术进步,消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势,消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于OLED显示屏具有更加轻薄的属性,其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为OLED屏的上游产业,晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。近年来OLED显示屏市场渗透率快速提升,根据Frost & Sullivan数据,2020年全球OLED显示驱动芯片出货量达到14.0亿颗,预计2025年全球OLED显示驱动芯片出货量达24.5亿颗,市场占比达到10.5%。OLED显示驱动芯片不断应用于高端电子消费产品和新能源汽车上,下游厂商对于OLED显示驱动芯片的品质要求越来越高,且集成电路设计和制造业技术不断进步,加快了各种封装技术和工艺水平的更新进步周期,需要相关封测厂商不断进行创新和改进技术水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,596,296,963.42	3,195,632,465.80	12.54	2,037,920,157.41
归属于上市公司股东的净资产	3,132,030,678.41	2,903,705,902.53	7.86	1,393,601,109.34
营业收入	1,238,293,041.85	939,652,817.36	31.78	796,699,928.99
归属于上市公司股东的净利润	196,985,017.79	177,224,972.73	10.59	140,318,168.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,194,709.94	126,181,697.44	33.30	93,931,888.59
经营活动产生的现金流量净额	351,469,642.36	601,141,680.25	-41.53	286,398,927.37
加权平均净资产收益率(%)	6.49	9.19	减少2.70个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.21
研发投入占营业收入的比例(%)	6.37	6.93	减少0.56个百分点	7.62

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	241,377,743.44	315,806,663.79	338,146,666.46	342,961,968.16
归属于上市公司股东的净利润	26,301,696.47	56,741,103.62	60,032,226.39	53,910,092.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,156,611.58	45,896,468.97	54,150,443.29	50,991,186.10
经营活动产生的现金流量净额	-47,803,567.22	53,210,896.83	102,444,304.59	148,008,873.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,883
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,371
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	0	174,103,622	20.85	174,103,622	174,103,622	无	0	其他
嘉兴喜和创业投资合伙企业(有限合伙)	0	60,000,000	7.19	0	0	无	0	其他
汇成投资控股有限公司	0	37,716,667	4.52	37,716,667	37,716,667	无	0	境外法人
安徽志道投资有限公司	-15,700,000	24,300,000	2.91	0	0	质押	21,730,000	境内非国有法人
杨会	0	23,593,934	2.83	23,593,934	23,593,934	无	0	境内自然人
Advance Allied Limited	-8,000,000	20,000,000	2.40	0	0	无	0	境外法人
四川鼎祥股权投资基金有限公司	0	18,181,818	2.18	18,181,818	18,181,818	无	0	境内国有法人
碧生电子科技(上海)有限公司	-1,000,000	16,000,000	1.92	0	0	无	0	境内非国有法人
安徽正奇资产管理有限公司	15,700,000	15,700,000	1.88	0	0	无	0	境内非国有法人
Great Title Limited	-9,850,000	15,153,889	1.82	0	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	①邓瑞俊、杨会为公司实际控制人,两人系夫妻关系。上述股东中,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)为核心担任执行事务合伙人的企业,汇成投资控股有限公司为实际能控制的企业,扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)与汇成投资控股有限公司、杨会构成一致行动人;②安徽志道投资有限公司与安徽正奇资产管理有限公司均为正奇控股股份有限公司的全资子公司。③嘉兴喜和创业投资合伙企业(有限合伙)系江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其3.06%的出资额。苏州邦盛聚源创业投资企业(有限合伙)持有江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)9.11%的出资额;嘉兴高和创业投资合伙企业(有限合伙)、杨会共苏州邦盛聚源创业投资企业(有限合伙)的有限合伙人,分别持有其3.33%、3.98%的出资额。南京邦盛聚源创业投资企业(有限合伙)持有江苏高投邦盛创业投资合伙企业(有限合伙)24.40%的出资额;杨会系南京邦盛聚源创业投资企业(有限合伙)的有限合伙人,持有其37.04%的出资额。除上述情形外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

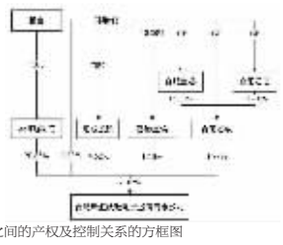
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

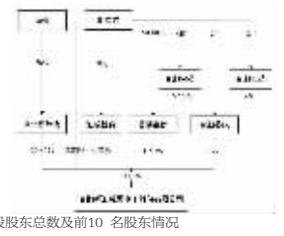
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入123,829.30万元,较上年同期增长31.78%;实现归属于上市公司股东的净利润19,598.50万元,较上年同期增长10.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,819.47万元,较上年同期增长33.30%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2024-030

合肥新汇成微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,结合公司绩效和职务贡献,并考虑公司规模、所处行业、所在地区等因素参照类似职务薪酬水平,制定了本次董事、监事和高级管理人员薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会事前审查认可,公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事郑瑞俊先生回避表决;董事和监事薪酬方案因全体董事和监事回避表决,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用期间和范围

本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事,方案自公司股东大会审议通过后生效,直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员,方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过后生效,直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。

公司将在2024年1月1日至新的薪酬方案审议通过日期间,按照本公告披露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。

二、薪酬标准

(一)董事薪酬

1、独立董事

独立董事采用固定津贴制,津贴标准为人民币5.50万元/年/人。

2、非独立董事

(1)公司董事长及在公司担任除董事外具体职务的非独立董事,参照可比公司类似岗位薪酬水平,依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

(2)未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

3、独立董事现场工作所需的合理费用、全部董事参加公司董事会和股东大会以及按相关规定行使职权所需的合理费用,公司给予实报实销。

(二)监事薪酬

1、在公司担任除监事外具体职务的监事,参照可比公司类似岗位薪酬水平,依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

2、未在公司担任除监事外具体职务的监事,不在公司领取薪酬。

3、监事出席公司监事会、股东大会以及按相关规定行使职权所需的合理费用,公司给予实报实销。

(三)高级管理人员薪酬

高级管理人员参照可比公司类似岗位薪酬水平,依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

三、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员具体薪酬以公司遵循监管部门要求披露的定期报告或其他公告列示的金额为准。

2、董事、监事、高级管理人员薪酬金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员因改选、辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算和发放薪酬。

四、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》第二十八条的规定,由董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2024年4月15日,公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议;全体委员对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议审查《关于董事薪酬方案的议案》,因全体董事为利益相关者需回避表决,同意将本次董事薪酬方案交由公司股东大会审议批准。本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》,郑瑞俊先生因兼任公司总经理而回避表决。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十九次会议审查《关于监事薪酬方案的议案》,因全体监事为利益相关者,需回避表决,同意将本次监事薪酬方案交由公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:688403　　证券简称:汇成股份　　公告编号:2024-029

合肥新汇成微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会于2024年3月25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成。经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名郑瑞俊先生、沈建纬先生、洪伟刚先生、朱景懿先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名罗昆先生、杨辉先生、阚智挺先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对独立董事候选人的资格审查情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会提名委员会关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见》。上述董事候选人简历详见公告附件。

独立董事候选人罗昆先生、杨辉先生、阚智挺先生均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明,具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。其中,罗昆先生为会计专业人士。

根据相关规定,候选独立董事需经上海证券交易所备案且无异议通过后方可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制进行选举。公司第二届董事会全体董事自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对任职资格审查,公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事候选人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。上述监事候选人简历详见公告附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和监事期限尚未届满的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间的勤勉、尽责,以及为公司发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件:候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

郑瑞俊,男,1963年1月出生,中国台湾人士,硕士学历。1994年7月至今,历任瑞成建筑工程(安徽)有限公司董事长、董事等职;2011年8月至今,历任江苏汇成光电有限公司董事、董事长、执行董事、总经理等职;2016年6月至2020年9月,任合肥新汇成微电子有限公司董事长;2020年9月至2021年3月,任合肥新汇成微电子有限公司董事长、总经理;2021年3月至今,任汇成股份董事长、总经理。

截至本公告披露日,郑瑞俊先生未直接持有公司股票,与其配偶杨会女士共同为公司实际控制人。郑瑞俊先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

沈建纬,男,1959年4月出生,中国台湾人士,高中学历。1987年11月至1993年5月,任建纬机械有限公司总经理;1993年5月至1999年7月,从事房产投资业务;1999年7月至今,历任瑞成建工程(安徽)有限公司总经理、副董事长、董事长等职;2011年8月至2020年8月,任江苏汇成光电有限公司董事;2016年6月至2021年3月,任合肥新汇成微电子有限公司董事;2021年3月至今,任汇成股份董事。

截至本公告披露日,沈建纬先生未直接持有公司股票,其女儿的配偶为公司监事陈殊凡先生。沈建纬先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

洪伟刚,男,1992年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年7月至2015年3月,任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部职员;2015年3月至2019年11月,任合肥市产业投资控股(集团)有限公司投资管理部投资助理;2019年11月至2023年3月,历任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部副总经理、总经理;2023年3月至今,任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理;2023年6月至今,任芯合半导体(合肥)有限公司董事长。

截至本公告披露日,洪伟刚先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

陈殊凡,男,1981年8月出生,中国台湾人士,本科学历。2007年5月至今,任瑞成建筑工程(安徽)有限公司稽核部长兼总经理秘书;2011年1月至今,任瑞成建筑工程(安徽)有限公司监事;2023年2月至今,任苏州格兰科医药科技有限公司董事;2023年5月至今,任汇成股份监事。

截至本公告披露日,陈殊凡先生未持有公司股票,系公司董事沈建纬女儿的配偶,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

独立董事候选人简历

杨辉,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1987年7月至1999年12月,任合肥经济技术学院教师;1999年12月至今,历任中国科学技术大学管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授;2021年3月至今,任汇成股份独立董事。

截至本公告披露日,杨辉先生未